

TJ硅基表面微结构激光精密蚀刻单晶硅异形切割

产品名称	TJ硅基表面微结构激光精密蚀刻单晶硅异形切割
生产厂家	天津华诺普锐斯科技有限公司
价格	37.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 最小孔径:20um 是否定制:是
公司地址	天津市西青区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路
联系电话	15320192158

产品详情

TJ硅基表面微结构激光精密蚀刻单晶硅异形切割

TJ硅基表面微结构激光精密蚀刻单晶硅异形切割

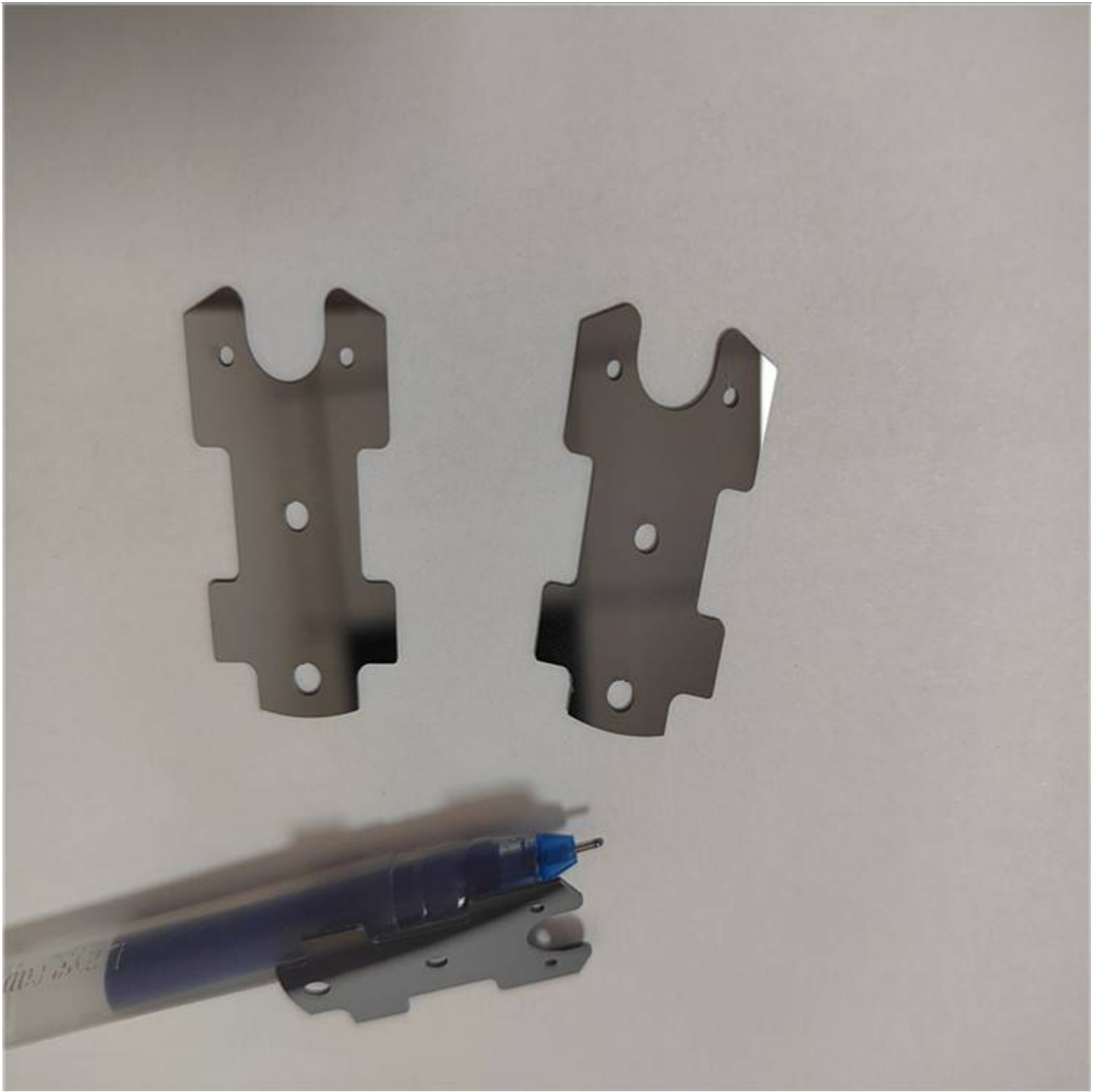
华诺激光是一家依托国际

*进激光技术，致力于激光切割异型切割小孔加工精密精细加工研发和代工服务的高科技企业，拥有一支经验丰富的激光切割异型切割小孔加工技术开发和管理团队，以及超过数十台的大族激光设备，包括大族激光的紫外激光切割异型切割小孔加工设备，光纤激光切割异型切割小孔加工设备，二氧化碳激光切割异型切割小孔加工设备等*进进*激光切割异型切割小孔加工设备。华诺激光专注于激光精密切割、打孔、微孔、小孔、细孔加工、狭缝切割、异形切割，可加工材质：不锈钢、铝、合金等金属材料以及玻璃、陶瓷、蓝宝石、硅

片等非金属材料！

可加工厚度： 2.5mm 精度： $\pm 0.02\text{mm}$







我司本着：

“质量第*，用户第*”的服务理念，完善的质量保障体系、合理的价格，真诚为用户提供专*的服务。

硅片激光切割的特点：

- 1、切缝质量好、变形小、外观平整、美观。

2、切割速度快、效率高、成本低、操作安全、性能稳定。

3、采用专*软件可随意设计各种图形或文字即时加工，加工灵活，操作简单、方便。

4、激光束易实现时间或空间分光，可进行多光束同时加工或多工位顺序加工。

华诺激光针对不同的客户需求，提供量身定制的服务和方案！
梁工竭诚为您服务，欢迎新老客户莅临指导！